



Solder plus Support

Underfill 620

Relleno

Características:

- Excelente función de capilaridad para flujo rápido
- Compatible con residuos de flux no clean
- No vacíos o huecos (voids)
- Retrabajable a 120°C
- Buenas propiedades de almacenamiento
- Viscosidad consistente

Descripción:

El Underfill 620 es un epoxy líquido de flujo rápido diseñado para uso como un relleno de flujo por capilaridad para ensamblajes de flip chip, CSP, BGA y uBGA. El Underfill 620 está diseñado para mejorar la confiabilidad de uniones de soldadura al minimizar el estrés inducido y proporcionar mejoramiento al rendimiento de ciclado de temperatura y excelente resistencia química. El Underfill 620 ofrece una confiabilidad superior a través de una alta Tg, bajo CTE, buen llenado, no vacíos, compatibilidad con residuos de flux de no limpieza y excelente adhesión. Velocidades más rápidas y yields más altos son logrados a través de la excelente acción de capilaridad, características de flujo y velocidad de curado más rápidas. El Underfill 620 puede ser retrabajado a 120°C. La viscosidad del Underfill 620 permanece estable a través de su vida útil. Este producto es apropiado para protección de chips desnudos en una amplia variedad de aplicaciones de dados pequeños.

Instrucciones de aplicación:

- Para mejores resultados, el sustrato de aplicación debe ser precalentado a 40-50°C. Aunque no se requiere, la boquilla de dispensado puede ser precalentada a fin de disminuir el aumento de viscosidad y velocidad de flujo.
- La presión del sistema debe ser moderada (15 a 40 psi). La velocidad debe ser también moderada (0.10 a 0.50 pulg/seg.). Además, la plataforma de dispensado debe ser capaz de mantener la punta de la aguja a aproximadamente 1-3 mm de la superficie del sustrato y de 1-3 mm del borde del chip. Esto asegurará la máxima consistencia de flujo del relleno.
- El patrón de dispensado para aplicaciones de dado pequeño (1/4") es típicamente de un solo lado o una esquina, y no requiere dispensado secundario o final en el perímetro. La baja viscosidad y excelentes características de mojado de este producto permiten al material el "auto-filete" a través del borde opuesto del dado.
- El patrón de dispensado para aplicaciones de dados más grandes es típicamente un patrón "L" a través de 2 lados, enfocándose en la esquina.
- El patrón de flujo debe ser diseñado para iniciar en la localización más lejana del centro del chip, lo cual ayuda a asegurar un relleno sin vacíos por debajo del dado. Además, el patrón de dispensado puede requerir un 2do o 3er dispensado con retardo de tiempo para fluir por abajo del chip. Un dispensado final para filete puede ser aplicado para asegurar una distribución uniforme de estrés en los bordes del chip.
- El Underfill 620 es retrabajable con calor. El procedimiento de retrabajo sugerido es calentar la parte a ser removida a su temperatura estándar de reflujo y removerla con una espátula plana.

TIEMPO DE CURADO @ 100°C	TIEMPO DE CURADO @ 125°C	TIEMPO DE CURADO @ 150°C
<10 MINUTOS	< 4 MINUTOS	<2 MINUTOS

Propiedades físicas:

APARIENCIA	GRAVEDAD ESPECIFICA	HUMEDAD	TOTAL DE VOLATILES	VISCOSIDAD A 25° C (77° F) a 5 RPM	PRUEBA DE DEL FLUJO CAPILAR	TG	CONTENIDO IONICO EXTRAIBLE
Líquido Rojo	1.1 G/CC	0.02%	<1%	30,000 cP	~30 segs	~125 °C	<10PPM

*El flujo actual depende de las condiciones ambientales y de aplicación.

Manejo y almacenamiento:

Temp °C	Tiempo:
25	N/R
4	1 mes
≤ -22	6 meses

Empaque:

El Underfill 620 no es higroscópico y por lo tanto puede ser empaquetado en jeringas, tarros, botellas y cartuchos.

Seguridad:

- Úselo con ventilación y equipo de protección personal adecuados.
- Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad del Material acompañante para toda información específica de emergencia.
- No deseche los materiales peligrosos en recipientes no aprobados.

Canadá +1-514-494-2000 · EUA +1-401-463-5605 · México +52-656-630-0032 · Europa +44-1737-222-258
Asia-Pacífico +86-755-2993-6487 · India +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com

La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. Toda información sobre la soldadura en pasta es producida con polvo de 45 micrones. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/Home/TermsConditions.aspx> para revisar términos y condiciones de AIM.